

2014年3月期 決算説明会

東京エレクトロン デバイス 株式会社

2014年4月28日

決算報告

代表取締役副社長

久我 宣之

株式売出し 自己株式取得

1. 東京エレクトロン株式会社(TEL)による当社株式売出し

売出株式数	売出し 1,484,000 株 オーバーアロットメント 222,600 株
売出価格	1株につき1,336円
目的	TEL:コアビジネスに経営資源集中 TED:独自性を高めた成長戦略を構築

2. 自己株式取得

取得株式数	636,000 株(TELが売却)
取得価額	859,872,000円(1,352円×636,000株)
取得日	2014年4月1日
目的	資本効率の向上、将来の経営環境の変化に対応する機動的な資本政策の遂行

【TELとの関係】

	属性	議決権割合	株主順位
異動前	親会社 連結子会社	55.42%	第1位
異動後	その他の関係会社 持分法適用関連会社	* 37.68%	第1位

* シンジケートカバー取引の実施状況により変動いたします。

業績予想修正

(百万円)

	2013.9.20 発表	2014.4.17 発表	増減額	増減率
売上高	97,000	101,801	+ 4,801	+ 4.9%
経常利益	1,050	1,039	▲ 11	▲ 1.0%
当期純利益	670	388	▲ 282	▲ 42.1%

差異理由

売上高 : 半導体及び電子デバイス事業で車載機器向け半導体が伸長、
商権拡大も寄与

経常利益 : 販売品目の構成比の変化による利益率の低下
外貨建て仕入値引債権一部回収不能
自社開発製品一部不具合に伴う損失計上

当期純利益 : 特別損失として投資有価証券評価損計上

業績 前期比較

(百万円)

	2013年3月期	2014年3月期	増減額	増減率
売上高	85,477	101,801	+ 16,323	+ 19.1%
売上原価	70,236	86,865	+ 16,629	+ 23.7%
売上総利益	15,241	14,935	▲306	▲2.0%
販管費	13,450	13,444	▲6	▲0.0%
営業利益	1,790	1,490	▲300	▲16.8%
営業外収益	52	75	+ 23	+ 44.4%
営業外費用	550	526	▲23	▲4.3%
経常利益	1,292	1,039	▲253	▲19.6%
特別損失	9	317	+ 308	—
当期純利益	658	388	▲270	▲41.1%
従業員数	948名	983名	—	—

売上高 :次スライド以降セグメント別に記載
売上総利益:利益率低下傾向
営業利益:販管費ほぼフラット
当期純利益:特別損失発生

セグメント別 売上高・利益

(百万円)

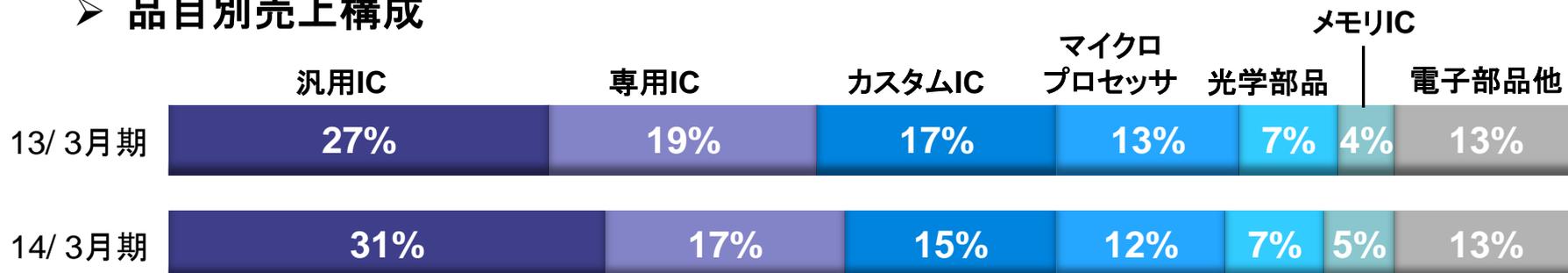
セグメント	2013年3月期		2014年3月期			
	売上高	セグメント利益	売上高	増減額 (増減率)	セグメント利益	増減額 (増減率)
半導体及び電子デバイス (EC)事業	70,641	154	86,255	+ 15,614 (+ 22.1%)	9	▲144 (▲94.1%)
コンピュータシステム関連 (CN)事業	14,835	1,138	15,545	+ 709 (+ 4.8%)	1,030	▲108 (▲9.5%)
合計	85,477	1,292	101,801	+ 16,323 (+ 19.1%)	1,039	▲253 (▲19.6%)

EC事業 : 為替換算差(円安)による売上増に加え、商権拡大や新商材も寄与
販売品目の構成変化により利益率低下、販管費増加もあり減益

CN事業 : データセンター向け機器販売堅調、クラウド関連新商材が寄与
機器・保守ともに価格低下圧力あり減益

セグメント情報 (EC事業)

品目別売上構成



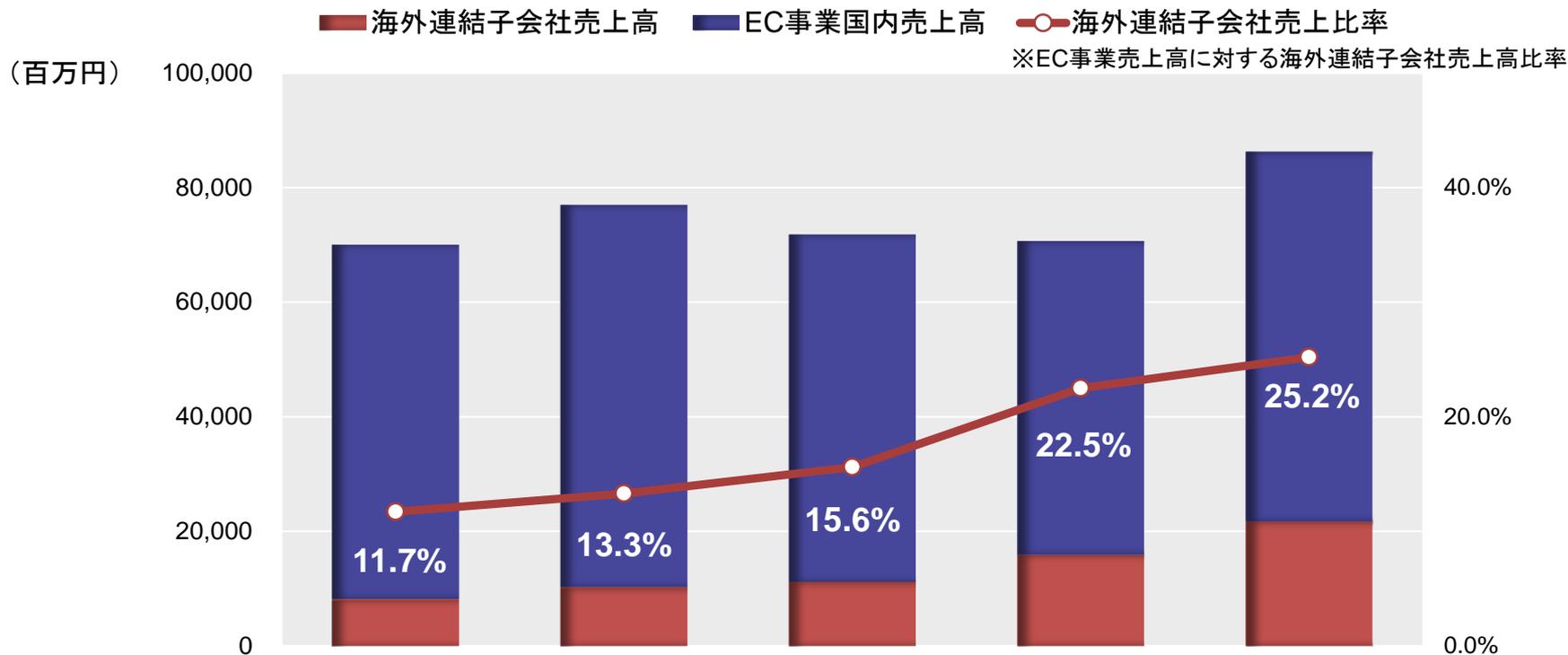
全品目で売上高前期比増加
特に商権拡大により 汎用IC + 40%、新商材 (FRAM SRAM) により メモリIC + 44%

用途別売上構成



医療機器など産業機器 + 23%、カーナビなど車載機器 + 83%

海外連結子会社売上高（EC事業）



	10/3月期	11/3月期	12/3月期	13/3月期	14/3月期
EC事業売上高	70,023	76,967	71,780	70,641	86,255
海外連結子会社売上高	8,186	10,265	11,172	15,868	21,699

216 million USD (前期比 + 13.2%)

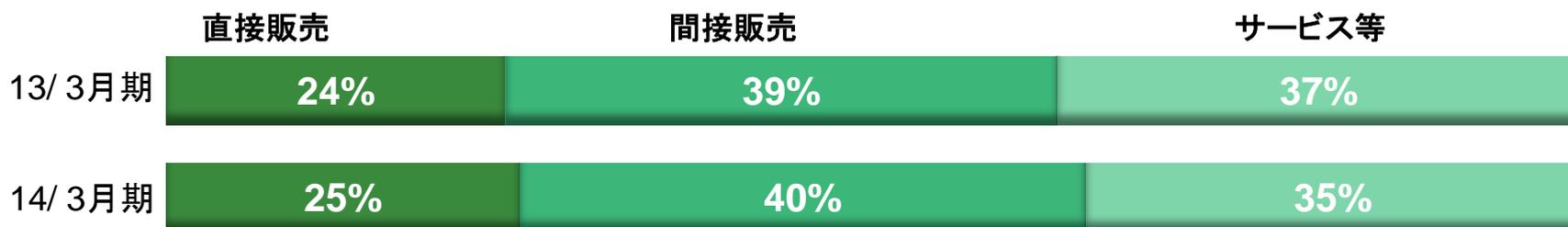
セグメント情報 (CN事業)

➤ 品目別売上構成



ネットワーク関連機器は官公庁ビジネスの減少を受け 売上高前期比 ▲1.1%
ストレージ関連機器はデータセンター向けが堅調、新商材も寄与 +12.5%

➤ 販売形態別売上構成

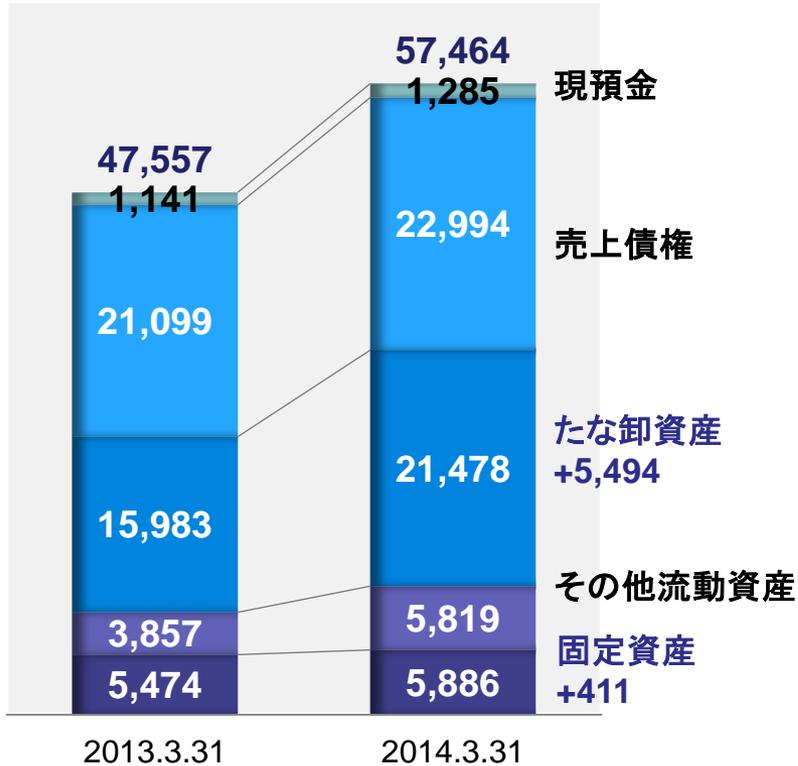


機器販売全体では増加 前期比 +8.7% 直接販売 +6.6% 間接販売 +10.0%
保守サービスは価格低下圧力の影響あり ▲1.8%

貸借対照表

➤ 資産

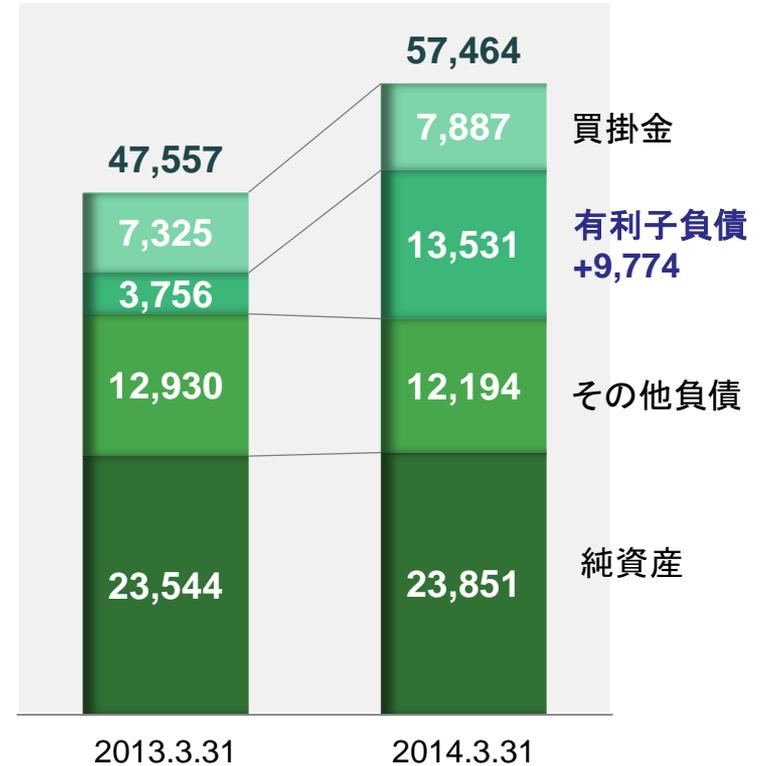
(百万円)



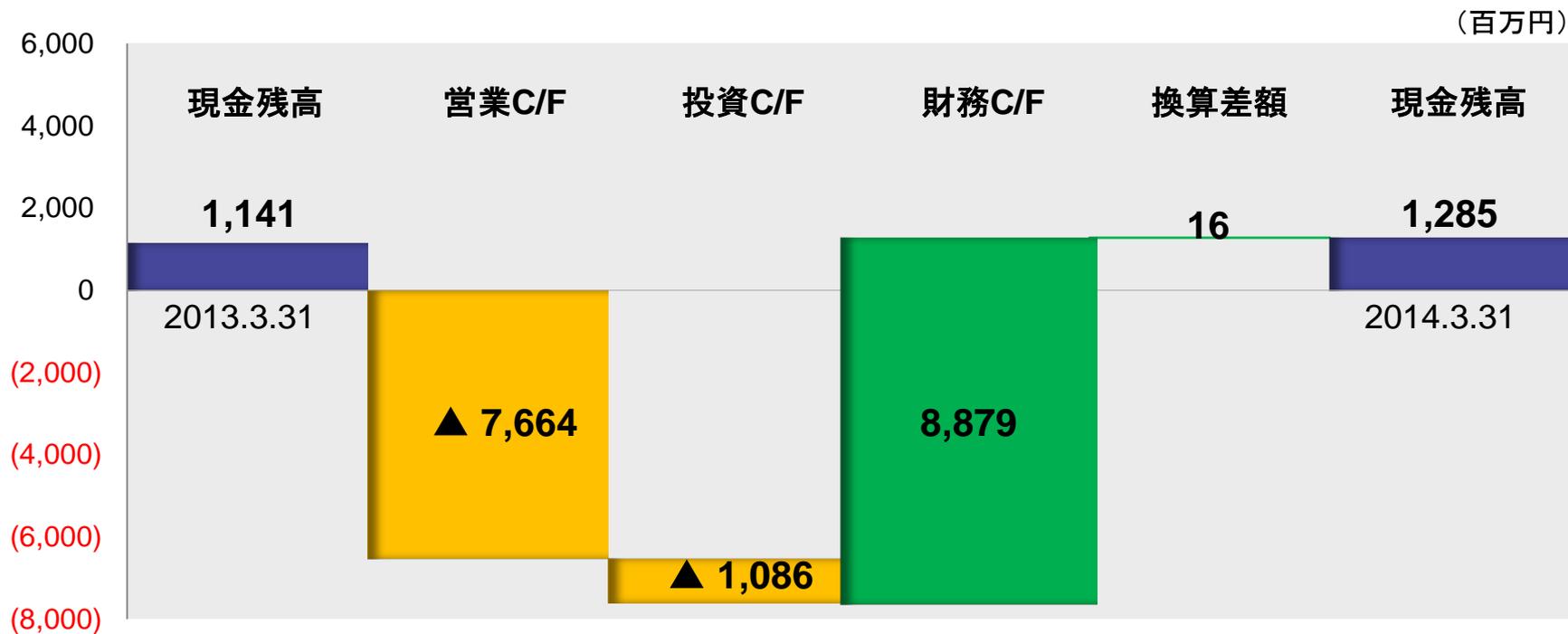
受注増加により たな卸資産増加
新基幹システムの導入等により固定資産増加

➤ 負債・純資産

(百万円)



たな卸資産増加による運転資金の調達にて
有利子負債増加



	2014年3月期	主な要因
営業C/F	▲7,664	たな卸資産の増加、売上債権の増加
投資C/F	▲1,086	ソフトウェア(基幹システム)の取得、関係会社株式の取得
財務C/F	8,879	短期借入金、長期借入金の増加

2015年3月期 活動方針と業績見込み

代表取締役社長

栗木 康幸

- ✓ 2014年3月期 取り組み
- ✓ 2015年3月期 活動方針と施策
- ✓ 2015年3月期 業績見込み
- ✓ 中期経営計画
- ✓ 配当について
- ✓ トピックス

EC事業の強化

- ◆ 海外ビジネスの拡大
- ◆ 自社商品(インレビウム)の拡大

CN事業の強化

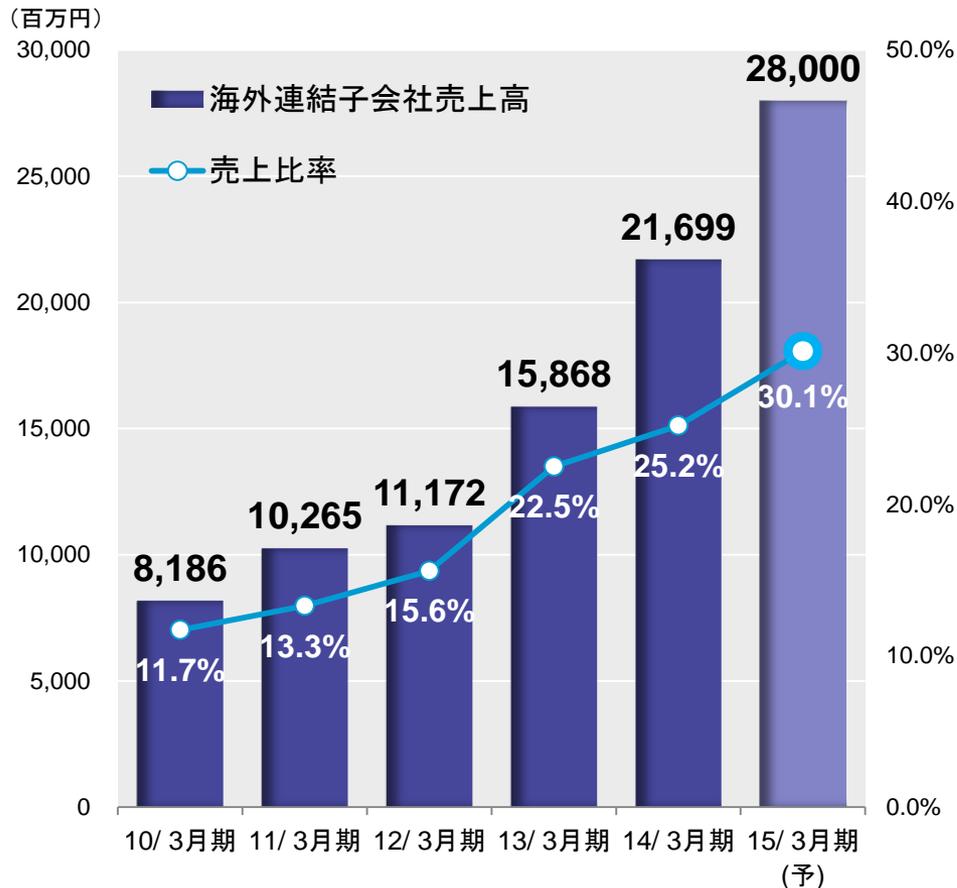
- ◆ トータルソリューション提供への取り組み
- ◆ データサービス等の新事業領域への挑戦

新規事業への進出

- ◆ 環境・省エネルギー分野への取り組み
- ◆ 新規商材開拓および新商流構築

2014年3月期 取り組み EC事業の強化 海外ビジネスの拡大

➤ 海外連結子会社売上高比率：EC事業の30%を目指す



取り組み：海外子会社の設立



<インレビウムアメリカ>
inrevium
 Inrevium AMERICA, INC.

【設立の目的】

北米における現地販売体制の構築
 インレビウム事業の拡大

【会社概要】

商号：inrevium AMERICA, INC.
 所在地：カリフォルニア州(シリコンバレー)
 設立：2013年9月
 営業開始：2014年1月

➤ Fidus Systems INC. の株式取得

概要



社 名 :Fidus Systems INC.
所在地 :カナダ オンタリオ州オタワ
設 立 :2001年12月
代 表 :Michael Wakim (President/CEO)
従 業 員 :技術系60名、その他 14名(2012年現在)
事業内容:ザイリンクス社FPGAを中心とした
デザインサービス専門会社

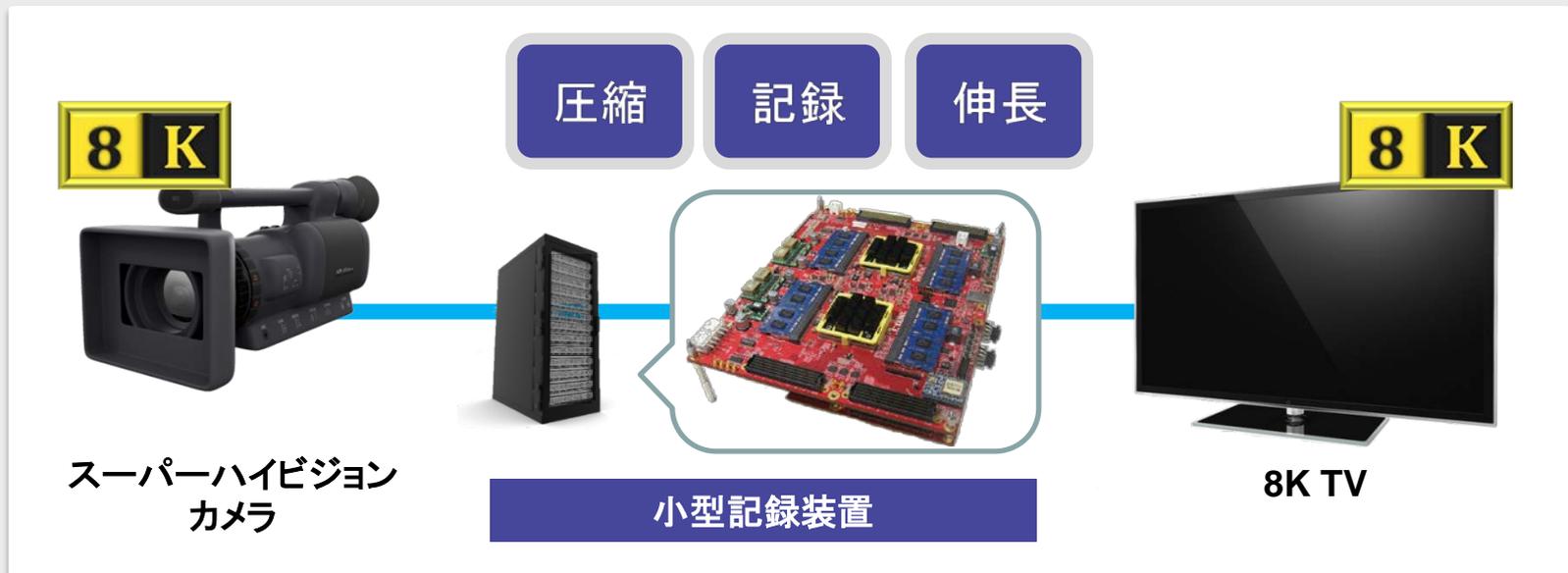
出資額:1,996,722USDドル(約2億円)

出資比率:20.6%(取得株式数998,361株/発行株式数4,846,408株)

出資目的:インレビウムビジネスの強化、北米市場の開拓

➤ 開発事例

NHK放送技術研究所様との共同開発「スーパーハイビジョン8Kカメラ用小型記録装置」



特 徴

- ・固体メモリを用いた小型記録装置
- ・圧縮技術の活用で、「装置の小型化」、「書込時間短縮」を実現

2014年3月期 取り組み CN事業の強化 データサービス等の新事業領域への挑戦

➤ 社内技術を活かし、データサービス等の新事業を展開

取り組み: 献立提案アプリサービス Ohganic<オーガニック>

The screenshot displays the Ohganic app's main interface. At the top, there's a navigation bar with the Ohganic logo and various settings icons. Below this, a section titled '今日の提案メニューはどれにしますか?' (Which menu do you want to choose today?) offers several filter options: 'おまかせ' (Recommended), '定番料理' (Classic dishes), '食材選択' (Ingredient selection), '体調管理' (Health management), and '病気予防' (Disease prevention). A central button says '提案献立を見る' (View proposals). The main content area features a grid of meal cards, each with a photo, title, and nutritional information. For example, one card shows '牛肉としとうのいためもの' (Stir-fried beef and carrots) with 500kcal and 15 minutes. Another card shows 'ローカロリー肉じゃが' (Low-calorie potato and meat) with 495kcal and 30 minutes. A sidebar on the right lists 'Ohganic 特別企画 献立?' (Ohganic Special Plan Recipes?) with items like '忙しい方にとったり!' (For busy people!) and '仕事も勉強も充実!' (Work and study are fulfilling!). At the bottom, there's a '最近見た献立' (Recently viewed recipes) section with a carousel of meal thumbnails.



Ohganicは、健康状態や病気予防など食事の目的に合った献立を提案するアプリサービス。

- ・Androidアプリ提供開始
- ・献立数を250万件から300万件まで拡充
- ・登録者数3万3千人、献立提案件数累計150万件
- ・病気予防の選択機能を拡充
(高尿酸血症予防、膀胱炎予防、アレルギー予防 など)
- ・献立提案の選択機能を拡充
(嫌いな食材選択 など)

<https://ohganic.com>

新規商材開拓および新商流構築(EC事業)

➤ 新規商材一覧 (EC事業)

取扱い開始	メーカー名	製品
2011年3月期	LYNK LABS社	特殊LEDモジュール
	Semikron社	パワー半導体
	Memsic社	MEMSセンサ
2012年3月期	Powercast社	環境発電デバイス(電波)
	Micropelt社	環境発電デバイス(温度差)
	Realtek社	ネットワーク向け専用IC
2013年3月期	Digi international社	M2M向けワイヤレスモジュール
	Cypress社	Psoc、USBコントローラ、SRAM
	Chilisin社	インダクター(巻線コイル)
2014年3月期	Rochester Electronics社	各種半導体
	Silego社	クロック、FPGA

通信インフラに採用

車載機器や産業機器を
中心に採用

新規商材開拓および新商流構築(CN事業)

➤ 新規商材一覧 (CN事業)

取扱い開始	メーカー名	製品
2011年3月期	Fusion-io社	PCI Express フラッシュ SSDストレージ
2012年3月期	Nicira社	ネットワーク仮想化 ソフトウェア
2013年3月期	Pure Storage社	オールフラッシュアレイ SSDストレージ
	Basho Technologies社	クラウドサービス構築用 ストレージソフトウェア
2014年3月期	Piston Cloud Computing社	クラウド管理ツール

富士通製PCサーバに採用

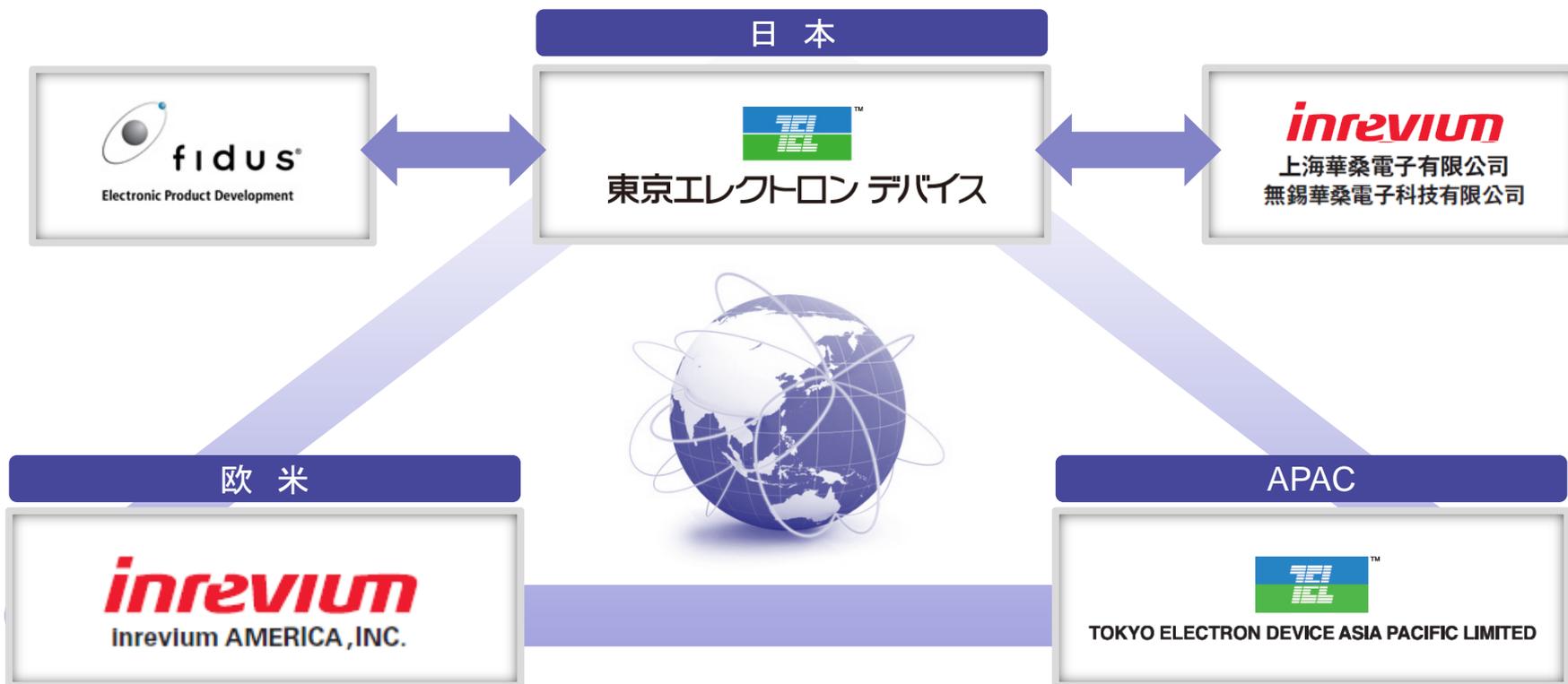
✓ **EC事業：インレビアムを海外に展開**

✓ **CN事業：保守体制の強化と新商材拡充**

✓ **新事業の開拓**

EC事業:インレビウムを海外に展開(1)

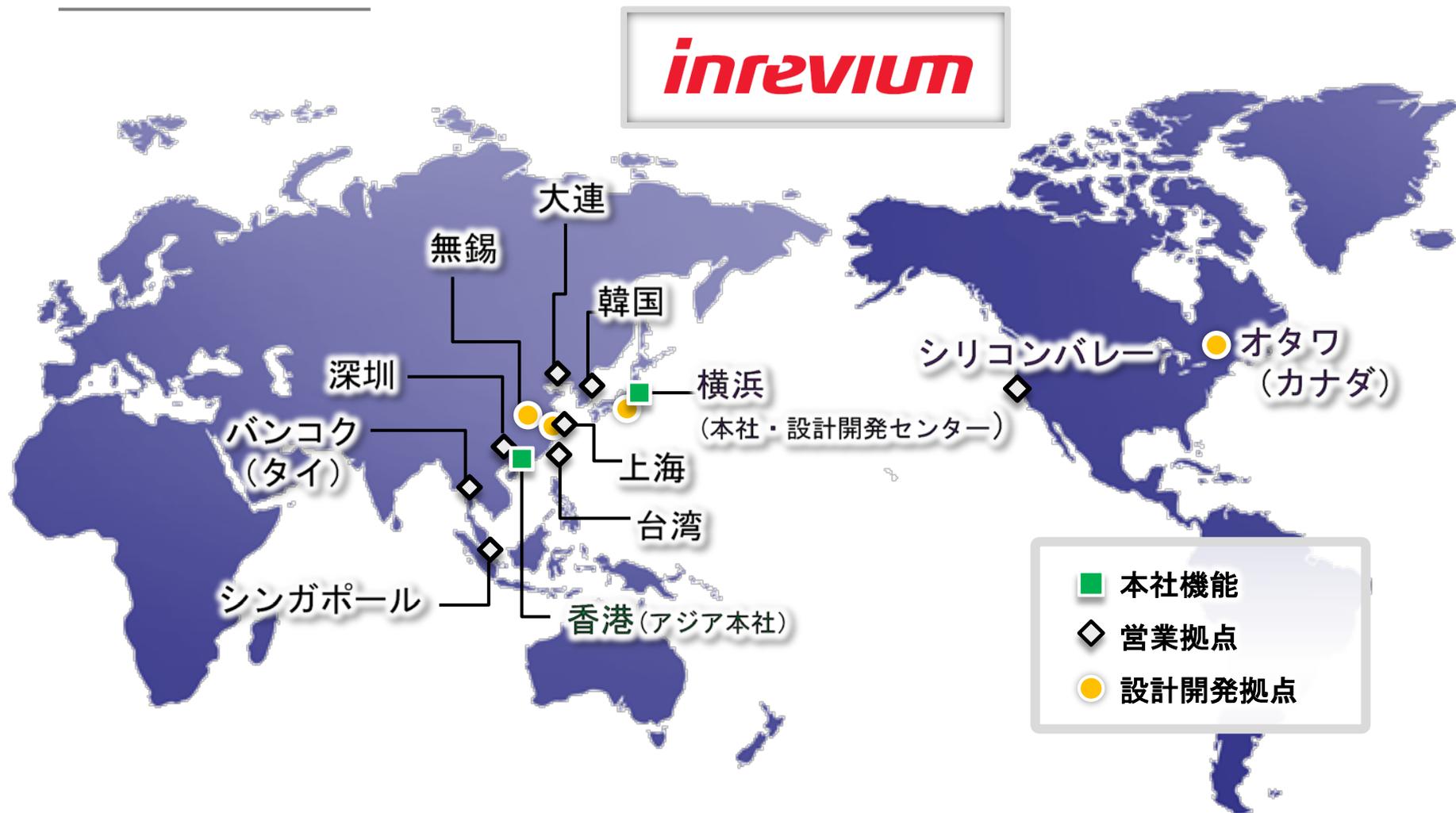
➤ 強化したインレビアムの設計開発体制を活かした海外展開



三極体制でインレビアムを海外に展開

EC事業:インレビウムを海外に展開(2)

➤ 海外拠点



CN事業：保守体制の強化と新商材拡充

➤ 保守体制の強化

ワンストップ
システム全体の
保守サポートを提供

エキスパート
日々教育訓練されたスキル
の高いエンジニアが対応

品質保証
納入時の品質検査、
品質保証も対応

お客様の多様なニーズに応えるため保守体制を強化

➤ クラウド分野を中心に新規取り扱い商品の更なる拡充



今後もお客様のニーズに沿った商品、市場性のある商品を投入

➤ 日本の製品をアジア市場に

環境・省エネルギー分野の新商材「Be NEXT～空調設備の省エネ管理装置」

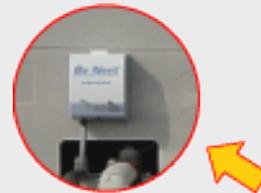


- ・工場、店舗などの空調設備の制御、記録を行う空調・冷凍機用 省エネ装置
- ・エネルギー資源価格の高騰により、省エネ対策に関心が高まっているアジア地域向けに販売

空調設備を細かく制御

稼働状況を記録

最適な省エネ対策を提案



➤ EC事業

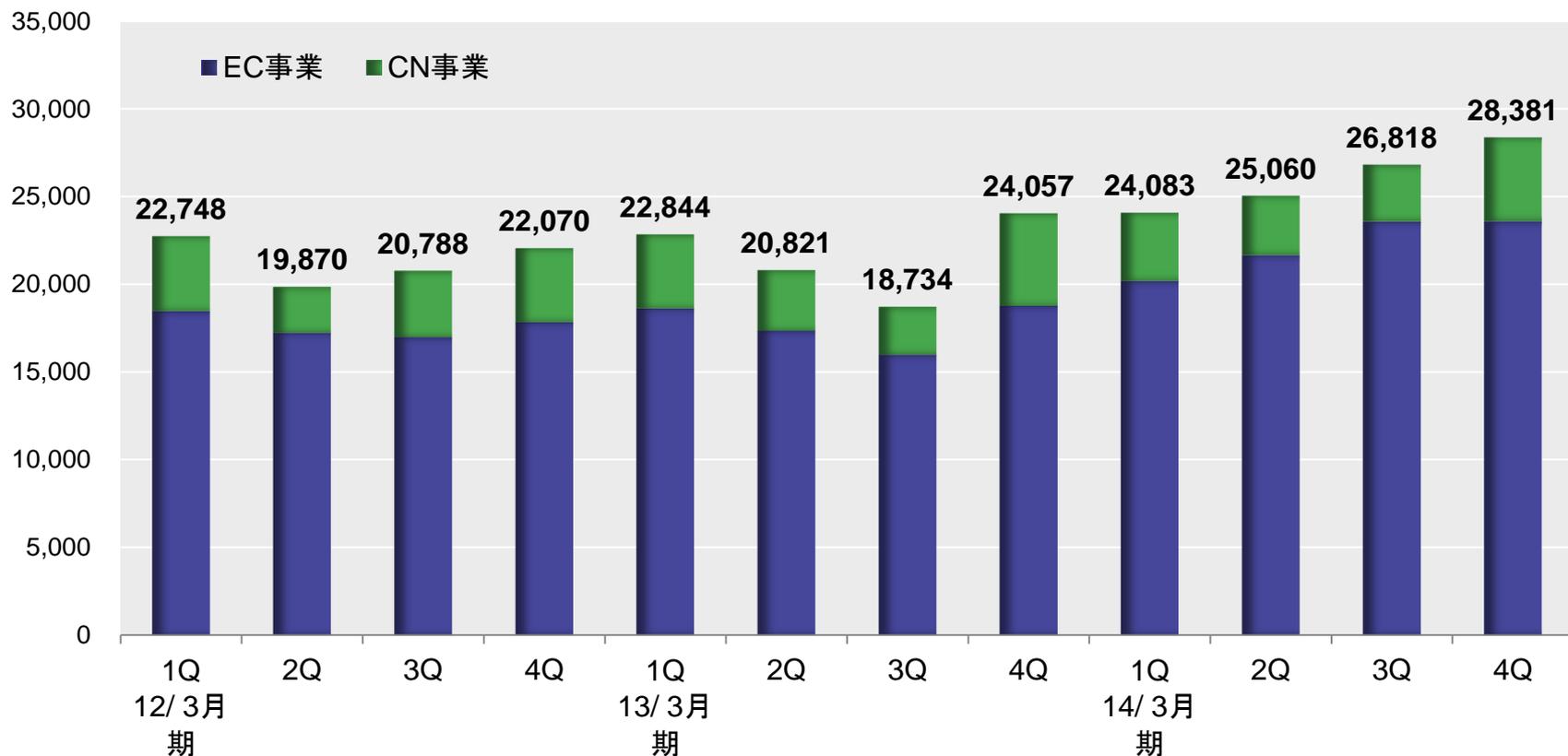
- ✓ 国内半導体市場は、消費税の影響あるものの回復を想定
- ✓ 海外半導体市場は、引き続きアジアの成長を想定
- ✓ 為替は、安定を想定

➤ CN事業

- ✓ クラウド普及により事業者データセンターのIT投資拡大を想定
- ✓ 次世代クラウド環境SDN(Software Defined Network)に注力
- ✓ 官公庁を含め国内IT投資は、下期偏重傾向

2014年3月期 受注高推移

(百万円)

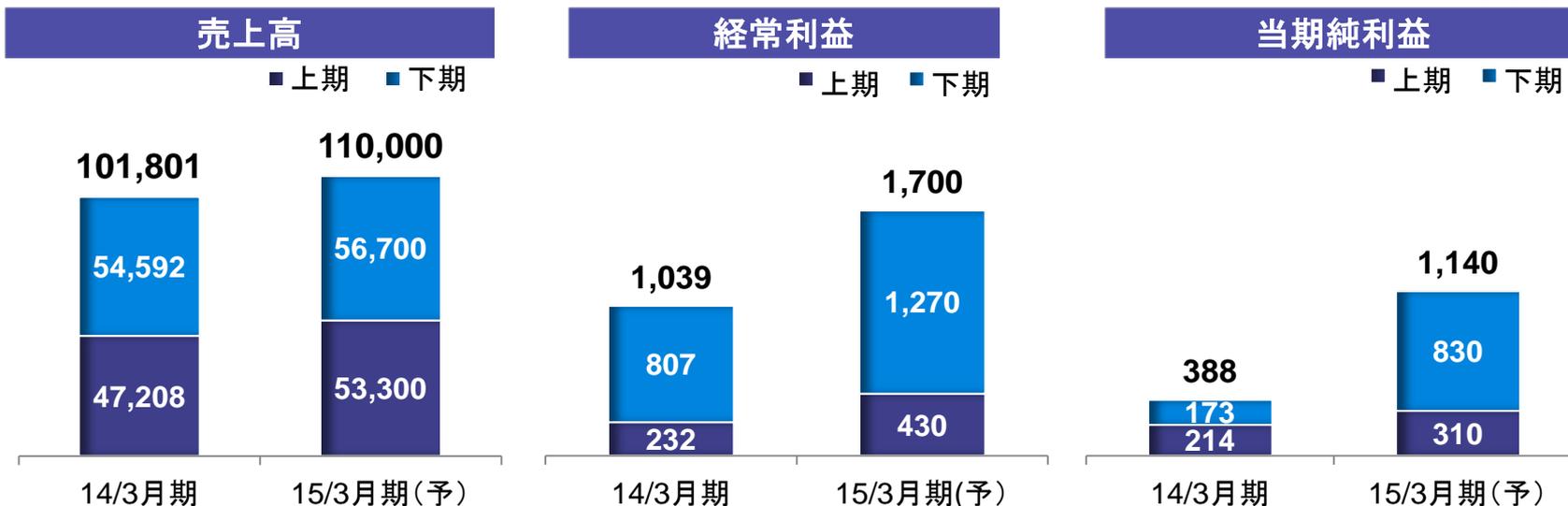


EC事業：2013年3月期 第4四半期より回復傾向

CN事業：官公庁ビジネスあり第 4四半期に受注増加

2015年3月期 業績予想

(百万円)



	2014年3月期	2015年3月期			対前年比	
	実績	上期予想	下期予想	通期予想	増減額	増減率
売上高	101,801	53,300	56,700	110,000	+ 8,198	+ 8.1%
EC事業	86,255	46,000	47,000	93,000	+ 6,744	+ 7.8%
CN事業	15,545	7,300	9,700	17,000	+ 1,454	+ 9.4%
経常利益	1,039 (1.0%)	430 (0.8%)	1,270 (2.2%)	1,700 (1.5%)	+ 660	+ 63.5%
当期純利益	388 (0.4%)	310 (0.6%)	830 (1.5%)	1,140 (1.0%)	+ 751	+ 193.8%

※()内は利益率

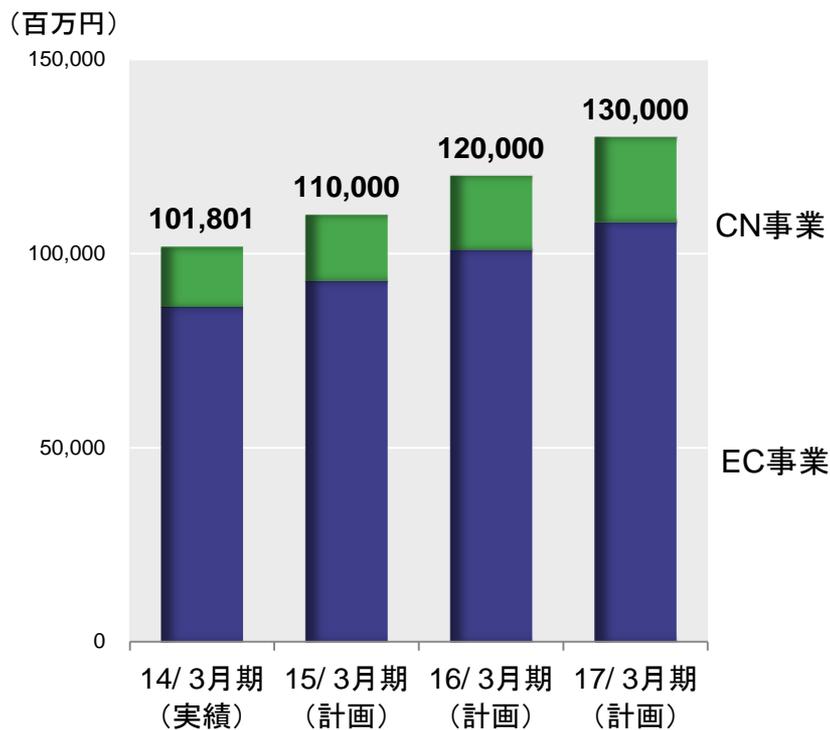
中期経営計画

Technical Support

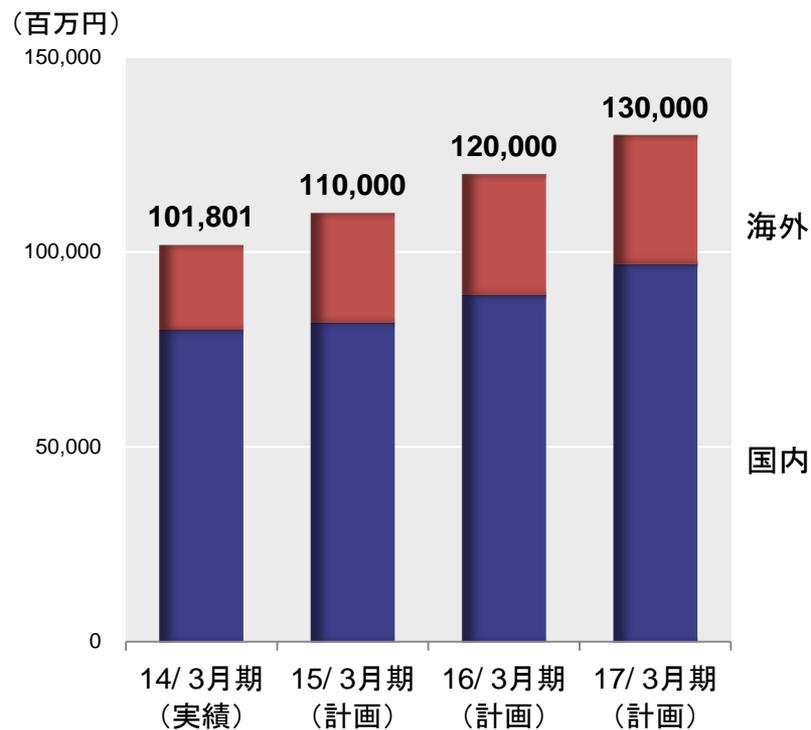
(百万円)

	2014年3月期	2015年3月期	2016年3月期	2017年3月期
	実績	計画	計画	計画
売上高	101,801	110,000	120,000	130,000
EC事業	86,255	93,000	101,000	108,000
CN事業	15,545	17,000	19,000	22,000
経常利益	1,039	1,700	2,500	4,000
経常利益率	1.0%	1.5%	2.1%	3.1%

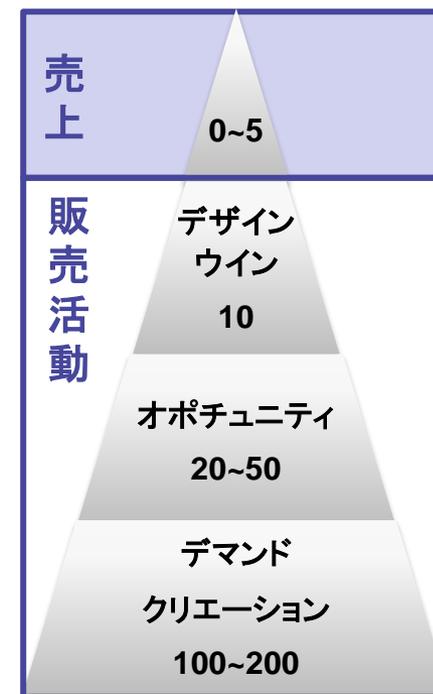
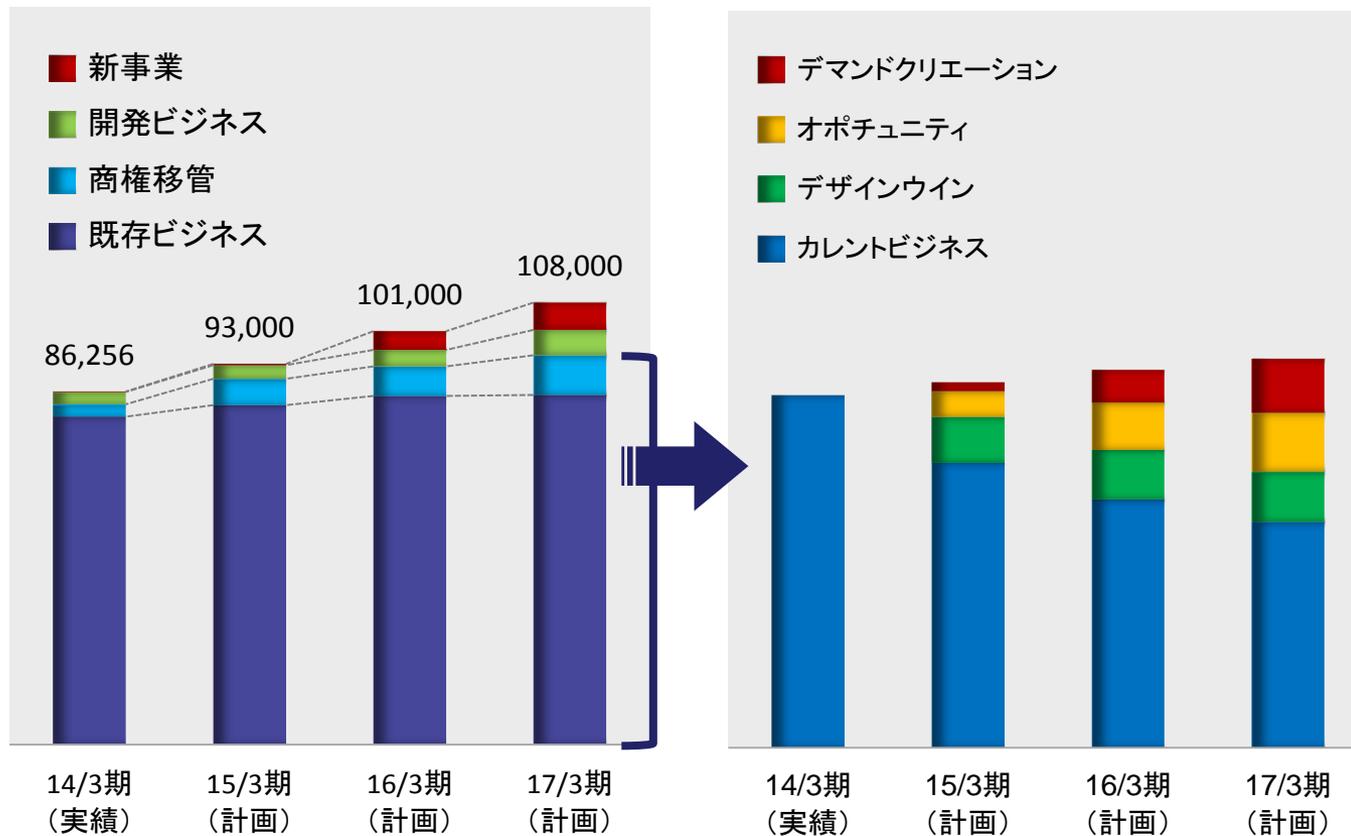
セグメント別 売上高構成比



地域別 売上高構成比



中期経営計画 内訳(EC事業)



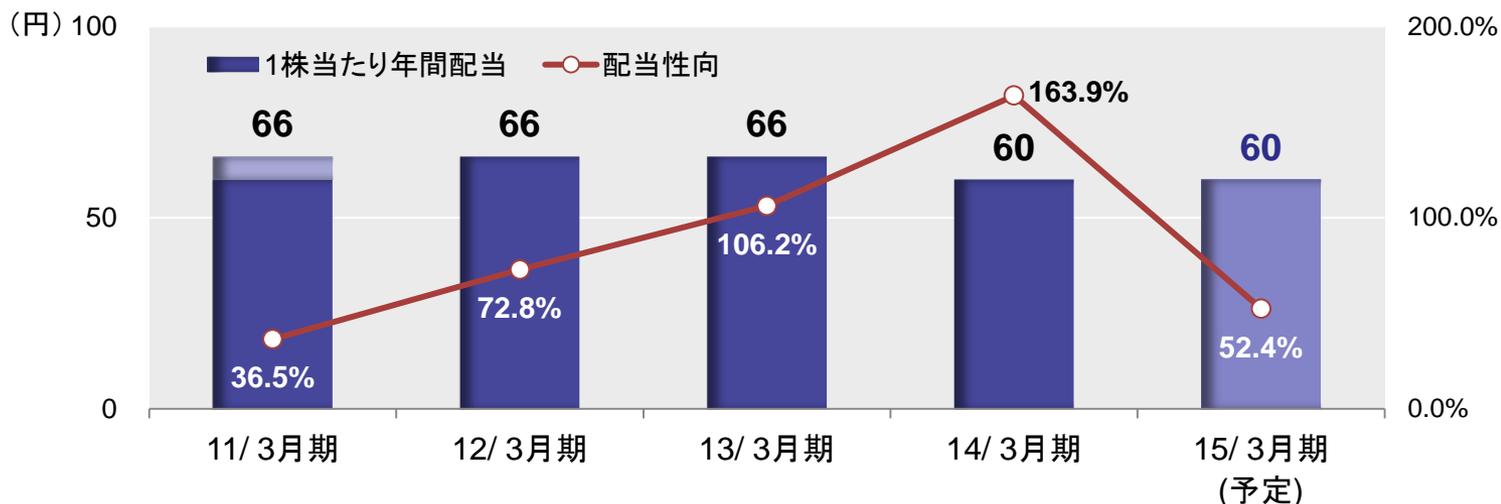
商権移管および新事業開拓による売上増を見込む

➤ 配当ポリシー

継続的かつ安定的な配当の実施を基本として、業績を反映した適正な利益還元を原則とし、当面の配当性向の水準については連結当期純利益の35%程度を目安

➤ 1株当たり年間配当金

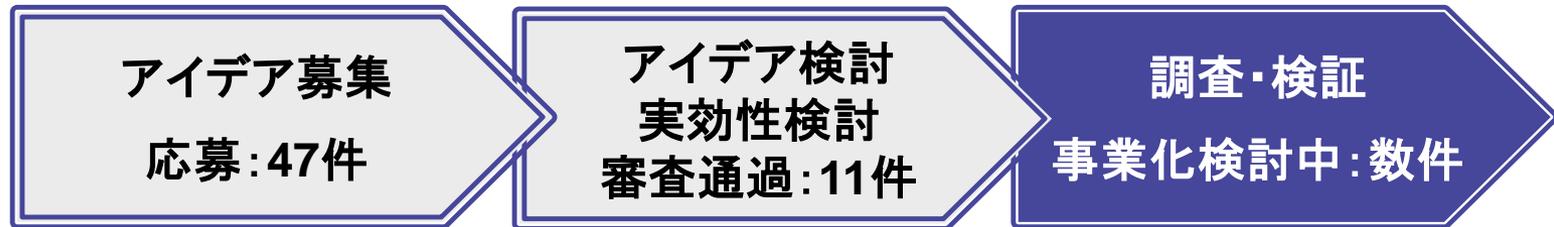
	2014年3月期	2015年3月期(予定)
中間	3,000円(分割調整後:30円) ※2013年10月1日を効力発生日として1株を100株に分割	30円
期末	30円	30円



※ 上記1株当たり年間配当金額は過去分まで遡及し、株式分割調整後の金額を記載しております。

新規事業創出への取り組み

➤ 既存事業とは異なる事業企画を社内公募



事業化検討例(CN)



BtoB向けクラウドサービス

最適な技術の検証、
市場性などリサーチ中

事業化検討例(EC)



スマートアグリビジネス^(※)

参入可能性の検証、実験中

※スマートアグリ=ITを活用した農業技術

➤ **新人事制度(人事制度改革)の趣旨** (2014年は準備期間、2015年からスタート)

- ✓ **経営環境の急激な変化に柔軟に対応**
- ✓ **社員一人一人が専門能力を得意分野で最大限に発揮できる環境を整備**
- ✓ **資格・職位によらず 個人の職務とパフォーマンスにふさわしい報酬を付与**

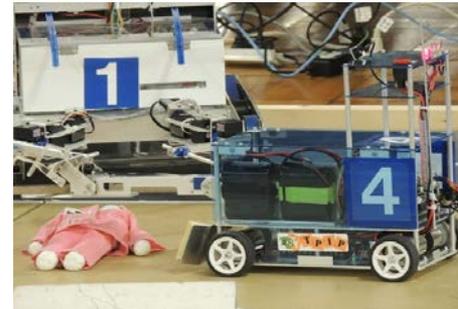
- CSR活動の一環として「レスキューロボットコンテスト」へ特別協賛

理念

技術を学び 人と語り 災害に強い世の中をつくる

第14回レスキューロボットコンテスト

inrevium 杯
by 東京エレクトロデバイス



予選 神戸会場:2014年6月29日(日) 東京会場:2014年7月6日(日)

本選 神戸会場:2014年8月9日(土)~10日(日)

今年は24チームが技術やアイデアを発表します。

補足資料

EC事業 品目別売上構成

品目別売上構成

	汎用IC	専用IC	カスタムIC	マイクロ プロセッサ	光学部品	メモリアIC 電子部品他	電子部品他
13/3月期	27%	19%	17%	13%	7%	4%	13%
14/3月期	31%	17%	15%	12%	7%	5%	13%

品目	増減率	主な要因	主な仕入先
汎用IC	+ 40.2%	商権拡大により全分野で増加 特にカーナビゲーション、家庭用ゲーム増加	TI / リニアテクノロジー / フリースケール
専用IC	+ 9.4%	TV、液晶プロジェクト減少もプリンタ等PC周辺機器増加	TI / ピクセルワークス / インターシル / サイプレス
カスタムIC	+ 12.9%	通信インフラ減少も産業機器増加	ザイリンクス / 富士通 / インレビウム
マイクロプロセッサ	+ 13.5%	カーナビゲーション増加	フリースケール / TI / インテル
光学部品	+ 19.7%	産業機器増加	アバゴ・テクノロジー
メモリアIC	+ 44.0%	新商材の立ち上がりにより増加	サイプレス / IDT / スパンション
電子部品他	+ 21.4%	POS端末増加	マイクロソフト / コーセル / インレビウム

※仕入先名は略称で記載しております。

EC事業 用途別売上構成

用途別売上構成

	産業機器	コンピュータ・周辺機器	民生機器	通信機器	車載機器
13/3月期	35%	23%	16%	17%	9%
14/3月期	35%	22%	15%	14%	14%

用途	増減率	主なアプリケーション	当社の傾向
産業機器	+ 23.1%	医療機器 放送機器 監視カメラ FA機器 工業用ロボット 工作機械 半導体製造装置 インバーター 計測器	全般的に回復
コンピュータ・周辺機器	+ 17.3%	複合プリンター 液晶プロジェクタ OA機器 タブレット PC及び付属機器 POS	POS端末、プリンタ増加 液晶プロジェクタ減少
民生機器	+ 14.4%	デジタルカメラ デジタルビデオカメラ TV DVD AV機器 家庭用ゲーム リモコン	家庭用ゲーム増加 TV減小
通信機器	+ 0.7%	携帯電話 スマートフォン ルーター 伝送装置 基地局	携帯端末減少
車載機器	+ 82.8%	カーナビゲーション カーオーディオ	カーナビゲーションがマーケット堅調に加え 商権拡大により大幅増加

CN事業 品目別売上構成

➤ 品目別売上構成



品目	増減率	主な要因	主な仕入先
ネットワーク関連機器	▲1.1%	官公庁向け減少、保守サービスも減少	エクストリームネットワークス社 F5ネットワークス社 インフォブロックス社
ストレージ関連機器	+12.5%	データセンター向け機器販売好調、新商材も寄与	ブロード社 EMC社(アイシロン データドメイン)
ミドルウェア他	+14.3%	ビッグデータ関連製品が好調	EMC社(グリーンプラム) オラクル社

※仕入先名は アルファベット順 略称で記載しております。

	品目	主な製品	機能
EC事業	汎用IC	アナログIC ロジックIC	色々な用途に共通に使用されるIC
	専用IC	画像処理用IC 通信用・ネットワーク用IC	特定用途用に作られた専用IC
	カスタムIC	ASIC PLD	お客様の仕様に応じて作られる固有IC
	マイクロプロセッサ	CPU DSP	電子機器の頭脳 演算機能・制御機能
	光学部品	発光ダイオード フォトカプラ	電気を光に変換して使用する電子部品
	メモリIC	SRAM FRAM MRAM フラッシュメモリ	記憶用IC 書込み読出しが可能なものや 読出しのみのものがある
	電子部品他	ソフトウェア ボード 電源 コネクタ	企業向け産業機器に組み込まれるソフトウェア プリント配線基板上にIC 電源 コネクタなどの部品を 実装した製品(ボード)
CN事業	ネットワーク関連機器	ネットワーク負荷分散装置、 セキュリティ関連機器	インターネットの接続負荷の分散、 ネットワーク上のセキュリティを強化
	ストレージ関連機器	SANスイッチ フラッシュストレージ	大容量データに高速に接続、記憶する
	ミドルウェア他	データウェアハウス用データ ベースソフトウェア 組み込みデータベース	データベース管理、クラウド環境の管理

ご参考: 主な仕入先

セグメント	品目	主な仕入先
EC事業	汎用IC	リニアテクノロジー社 TI 社
	専用IC	コネクサントシステムズ社 サイプレス社 IDT社 インターシル社 メムシック社 ピクセルワークス社 リアルテック・セミコンダクター社 シリコンイメージ社 TI社 ビクシシステムズ社 インレビウム
	カスタムIC	富士通セミコンダクター(株) ザイリンクス社 インレビウム
	マイクロプロセッサ	フリースケール・セミコンダクタ社 富士通セミコンダクター(株) インテル社 TI 社
	光学部品	アバゴ・テクノロジー社
	メモリIC	サイプレス社 IDT社 スパンション社
	電子部品他	コーセル(株) マイクロソフト社 インレビウム
CN事業	ネットワーク関連機器	エクストリームネットワークス社 F5ネットワークス社 インフォブックス社
	ストレージ関連機器	ブロード社 EMC社(アイシロン データドメイン)
	ミドルウェア他	EMC社(グリーンプラム) オラクル社

※仕入先名は アルファベット順 略称で記載しております。

このプレゼンテーションで述べられている将来の当社事業に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに構築されたものです。

当社の参画するエレクトロニクス業界及びIT業界は変化のスピードが大変速く、また、世界経済、半導体市況など、当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。

したがって、今後当社の業績見通しが本プレゼンテーションと異なる可能性があることをご注意ください。
また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。